

## 北京四维图新科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期 及子项目调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 本次拟延期部分募投项目及子项目调整的情况：

1、拟将“智能网联汽车芯片研发项目”、“自动驾驶专属云平台项目”的预定可使用状态日期由2025年12月分别延期至2028年12月和2026年12月。

2、拟终止“智能网联汽车芯片研发项目”项下研发子项目：Low cost DA 芯片 AC8005 和视觉处理芯片 AC6815。新增研发子项目：高性价比网联仪表 SoC AC8117 和高性能 5G 车联网 IVI SoC AC8277。不涉及“智能网联汽车芯片研发项目”拟投入募集资金总额的调整。

- 本次部分募投项目延期及子项目调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东会审议

### 一、募集资金基本情况

经公司2020年8月27日召开的第五届董事会第三次会议决议、

2020年9月18日召开的2020年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375号）核准，公司非公开发行3.2亿股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行认购价格为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币40亿元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币25,271,698.11元，实际募集资金净额为人民币3,974,728,301.89元，于2021年2月3日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年2月4日出具“XYZH/2020BJAA70042”号验资报告。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方/四方监管协议。

## 二、募投项目基本情况

截至2025年11月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）基本情况如下：

单位：万元						
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	已投募集资金占比	原计划达到预定可使用状态日期
1	智能网联汽车芯片研发项目	163,955.62	123,987.00	68,873.23	55.55%	2025年12月
2	自动驾驶地图更新及应用开发项目	109,098.98	101,776.81	99,910.03	98.17%	2024年12月
3	自动驾驶专属云平台项目	73,536.56	72,416.56	52,369.27	72.32%	2025年12月

4	补充流动资金项目	99,292.46	99,292.46	99,292.46	100.00%	
合计		445,883.62	397,472.83	320,444.99	-	-

注：自动驾驶地图更新及应用开发项目已于 2024 年 12 月结项。

### 三、本次募投项目延期情况

#### （一）部分募投项目延期的具体情况

基于对项目当前进度、行业技术发展趋势及资源配置效率的研判，结合项目整体推进规划与实际实施情况，经公司审慎研究，拟对“智能网联汽车芯片研发项目”、“自动驾驶专属云平台项目”达到预定可使用状态的时间予以延期，具体调整情况如下：

项目名称	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
智能网联汽车芯片研发项目	2025 年 12 月	2028 年 12 月
自动驾驶专属云平台项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月

#### （二）部分募投项目延期的主要原因

##### 1、智能网联汽车芯片研发项目

全球电动汽车市场结束爆发式增长，进入平台期，车企对芯片采购趋于保守，影响研发投入回报预期。部分车企从“全栈自研”转向合作或采购成熟方案，降低了对定制化高端芯片的迫切需求。结合车规芯片研发周期长、认证成本高的特点，终端车企持续降价压力传导至上游，挤压芯片利润空间，因此公司对前沿技术投入更谨慎。车联网芯片需支持 5G-V2X、高精度定位、边缘 AI 计算等多功能集成，

---

设计难度呈指数级上升，且需兼顾功耗、散热与车规可靠性，并且跨领域技术融合（通信、AI、安全）对研发团队能力和跨行业协作提出更高要求。全球车联网通信标准尚未完全统一，自动驾驶演进路径的不确定导致芯片设计面临路线选择风险，公司需要进行多版本布局，增加设计迭代复杂度。综上，由于技术复杂度提升以及标准化差异等因素，拉长了研发周期。此外，公司为提升资金使用效益，将终止项目的募集资金重新调配用于存续及新增项目，相关流程对项目阶段性推进节奏也产生了一定影响。为确保项目实施质量，公司审慎决定将该项目募集资金使用期限延期至 2028 年 12 月。

## 2、自动驾驶专属云平台项目

2025 年，AI 平台架构迭代推动行业生态发生结构性变化。科技巨头主导的通用大模型开放式“AI 基础平台”已成主流，可直接提供高阶自动驾驶感知、决策与数据闭环能力，促使行业合作范式转变为“主机厂定义场景 + AI 平台提供核心能力”，车企对独立底层专属云平台的需求紧迫性降低，项目需重新适配技术路径与合作模式，同时推动平台底层架构与 AI 大模型训练、优化需求动态匹配。与此同时，基于智驾数据闭环应用场景的汽车数据流通安全技术作为自动驾驶专属云平台实现数据合规、脱敏及安全存储的核心支撑，2025 年一直处于关键建设阶段。为确保该技术成果充分融入平台架构，实现与智驾数据闭环场景的深度适配，需预留充足时间完成技术的集成测试与优化迭代工作。鉴于 AI 技术平台的关键性变化已成为影响行业发展的核心变量，且核心安全技术的建设完善直接决定平台的核心

---

竞争力，本公司经审慎评估，决定对“自动驾驶专属云平台项目”的建设进度进行战略性调整，将预定可使用状态延期至 2026 年 12 月。

本次项目延期是公司基于实际情况审慎作出的决策，核心目的在于保障研发质量，规避技术风险。后续，公司将强化项目管理，统筹推进研发进程，力争尽早达成项目目标，切实维护全体投资者利益。

#### 四、本次部分募投项目子项目调整的具体情况

##### （一）“智能网联汽车芯片研发项目”原计划与实际投资情况

公司拟通过“智能网联汽车芯片研发项目”整合公司现有芯片设计的能力，致力于向车厂输出以“算法+芯片”为核心的完整的 ADAS 解决方案能力，抓住自动驾驶市场发展的机遇。项目内容致力于推进已有芯片产品的研发和量产进度，加强与产业链上下游以及软硬件一体化垂直整合，项目总投资为 163,955.62 万元（最终金额以实际投资为准），拟投入募集资金金额为 123,987.00 万元。在项目推进过程中，公司结合市场环境变化与发展的实际需求情况，对“智能网联汽车芯片研发项目”进行了合理延期，具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站的相关公告：2024 年 10 月 31 日发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-063）

截至 2025 年 11 月 30 日，募投项目“智能网联汽车芯片研发项目”累计投入募集资金 68,873.23 万元，占拟使用募集资金总额的 55.55%，剩余募集资金 66,915.15 万元（含利息）存放于募集资金专

---

户，公司严格依据相关法律法规及专户协议，规范开展管理工作。

## （二）“智能网联汽车芯片研发项目”子项目调整的情况

### 1、拟终止“智能网联汽车芯片研发项目”项下研发子项目的具体情况

考虑到当前行业发展趋势、市场环境及公司实际经营情况较募投项目规划初期已发生较大变化，相关技术路径亦发生了迭代升级，公司立足于战略发展定位，从技术可行性、市场成长前景、投入效益等多个维度，对整体研发布局进行系统审视。结合对各子项目研发进展、行业竞争态势及公司长期战略优先级的综合评估，公司认为其中部分项目已不再具备持续推进的商业化价值与实施可行性。截至目前，相关子项目未实际发生投入。经过审慎研究，决定对相关子项目予以终止，具体情况如下：

#### （1）Low cost DA 芯片 AC8005

AC8005 芯片在初期规划时主要应用于前装超低阶车载信息娱乐系统（DA）市场。然而，随着国内汽车产业“新四化”（电动化、网联化、智能化、共享化）进程在国家产业政策引导下加速推进，尤其是智能座舱与车联网技术的快速普及，市场对车载芯片的性能、集成度及智能化水平提出了更高要求。传统功能相对单一的 DA 市场空间受到显著挤压，其萎缩速度超出行业早期预期。与此同时，市场同质化竞争日趋激烈，多家厂商已推出多款同档位高性能、低成本竞品芯片，导致该细分赛道陷入激烈的价格战，进一步压缩了产品的盈利空

---

间与长期价值。综合来看，AC8005 芯片在技术定位、成本结构及未来市场需求等方面，已难以匹配公司当前的发展战略与市场现实。经公司审慎评估与充分论证，现决定终止 AC8005 芯片的研发项目。

## （2）视觉处理芯片 AC6815

AC6815 主要用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）功能。近年来在政策推动与技术演进的双重作用下，国内汽车智能化进程显著提速。一方面，随着《新能源汽车产业发展规划》等政策的深入实施，电动汽车市场快速扩张，带动 ADAS 功能加速普及。特别是以高速领航辅助驾驶（NOA）为代表的高阶智能驾驶功能，正逐步成为中高端车型的竞争焦点，市场对芯片算力、能效及多传感器融合处理能力提出了远高于以往的刚性需求。另一方面，行业技术路线也正朝着“舱驾一体”融合计算、大算力集中式架构快速演进。相比之下，AC6815 在架构设计与算力水平上已难以匹配未来主流 ADAS 系统的发展要求。同时，公司在功能安全、预期功能安全及系统级优化等方面的技术积累尚未形成足够的差异化竞争优势，导致该芯片在商业落地潜力上未达到预期。因此，公司决定终止 AC6815 芯片的研发项目。

本次终止“智能网联汽车芯片研发项目”项下 2 个子项目，是公司基于行业发展趋势、市场竞争态势与技术路径演进的系统性评估所作出的主动调整。这一决策旨在优化研发资源配置，将资源进一步聚焦于符合公司长期战略、具备更高技术壁垒和市场前景的核心研发方向。

---

## 2、拟新增“智能网联汽车芯片研发项目”项下研发子项目的具体情况

### （1）高性价比网联仪表 SoC AC8117

国内电动两轮车行业快速发展，新国标(GB17761—2024)于 2025 年 9 月 1 日正式生效，首次将北斗定位、通信与动态安全监测功能纳入强制要求。这意味着符合新国标的电动两轮车必须集成蜂窝通信能力，以实现车辆状态实时上报、位置追踪和安全预警。Cat.1 模组因其低功耗、高稳定性和支持北斗/GNSS 定位的特性，成为满足这一要求的核心技术方案。

AC8117 整合了全球导航卫星系统 (GNSS) 定位与第一类蜂窝物联网 (Cat1) 网联功能，可充分满足未来电动两轮车智能化的强劲需求，具备极为可观的市场前景；该芯片方案可以为电动两轮车提供高性价比的智能化解决方案，通过集成先进的通信与定位技术，助力整车厂快速响应新国标要求，提升产品竞争力。项目的成功实施，有望使公司在快速增长的电动两轮车智能化市场中占据有利地位，进一步拓展公司在智能网联领域的业务版图。经审慎评估，公司拟新增高性价比网联仪表 SoC AC8117 作为“智能网联汽车芯片研发项目”项下子项目，从而加快该项目研发进程，为公司持续发展奠定坚实基础。

### （2）高性能 5G 车联网 IVI SoC AC8277

2025 年 1-7 月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配 5G 车联网功能前装搭载交付 272.76 万辆，同比增长 129.21%，5G 通信模

---

组搭载率已接近 26%，智能座舱的快速普及与应用繁荣，车联网已经成为人车交互、用户体验关键一环，对高性能 5G 智能网联通信的需求急剧攀升；而当前高阶辅助驾驶的升级，同样亟需更高速、更低延时、更高精度的 5G 车载通信能力作为支撑。

高性能 5G 车联网 IVI SoC AC8277 通过高度集成的架构设计，将 5G 和 4G 通信能力与座舱域控制功能深度融合，在提供高速率、低时延车联网连接的同时，可有效降低硬件成本和功耗，提升系统集成度。其高性能的计算处理能力能够支持多屏互动、高清影音娱乐、AR 导航等丰富的座舱智能化应用场景，为用户带来更流畅、更智能的交互体验。此外，该芯片严格遵循车规级可靠性和安全性标准，可充分满足《GB 45672—2025 车载事故紧急呼叫系统》等相关国家标准的技术要求，确保在各种复杂工况下的稳定运行，为车辆的安全行驶和紧急救援提供坚实保障，具有广阔的市场应用前景。

为提高募集资金使用效率，结合市场需求及行业趋势，经审慎评估，公司拟新增高性能 5G 车联网 IVI SoC—AC8277 作为 “智能网联汽车芯片研发项目” 项下子项目，从而加快该项目研发进程，为公司持续发展奠定坚实基础。

### 3、“智能网联汽车芯片研发项目”子项目及金额调整的具体情况

本次调整前，公司募投项目“智能网联汽车芯片研发项目”包含智能座舱芯片 AC8025、车联网芯片 AC8267、Low cost DA 芯片

---

AC8005、高阶智能座舱芯片 AC8035、视觉处理芯片 AC6815 等共计 5 个子项目。公司基于现阶段技术发展趋势与市场格局变化，经审慎论证后，拟决定终止 Low cost DA 芯片 AC8005、视觉处理芯片 AC6815 子项目。截至 2025 年 11 月 30 日，“智能网联汽车芯片研发项目”已投入募集资金 68,873.23 万元。截至 2025 年 11 月 30 日，“智能网联汽车芯片研发项目”剩余募集资金 66,915.15 万元（含利息）将继续投入到在研项目以及新增的高性价比网联仪表 SoC AC8117 项目和高性能 5G 车联网 IVI SoC AC8277 项目中。本次调整仅涉及“智能网联汽车芯片研发项目”分项目的内部项目变更及金额调整，不涉及“智能网联汽车芯片研发项目”拟投入募集资金总额的调整。

## 五、募投项目延期及子项目调整对公司的影响

本次部分募投项目延期及子项目调整是根据募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划等综合考虑做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

## 六、专项意见

### （一）董事会审计委员会意见

---

审计委员会认为：本次部分募投项目延期及子项目调整是根据募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划等综合考虑做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

## （二）董事会意见

将“智能网联汽车芯片研发项目”、“自动驾驶专属云平台项目”的预定可使用状态日期由 2025 年 12 月分别延期至 2028 年 12 月和 2026 年 12 月；拟终止“智能网联汽车芯片研发项目”项下研发子项目：Low cost DA 芯片 AC8005 和视觉处理芯片 AC6815；新增研发子项目：高性价比网联仪表 SoC AC8117 和高性能 5G 车联网 IVI SoC AC8277。不涉及“智能网联汽车芯片研发项目”拟投入募集资金总额的调整。

本次部分募投项目延期及子项目调整是根据募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划等综合考虑做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

---

### （三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

四维图新本次对非公开发行募集资金投资项目延期及子项目调整的事项，经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次募投项目延期及子项目调整是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对四维图新本次募集资金投资项目延期及子项目调整事项无异议。

### 七、关于本次部分募投项目延期及子项目调整提交股东会审议的相关事宜

本次部分募投项目延期及调整子项目的事宜已经第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会办公室

二〇二五年十二月二十三日